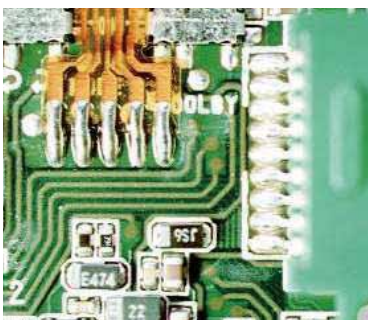
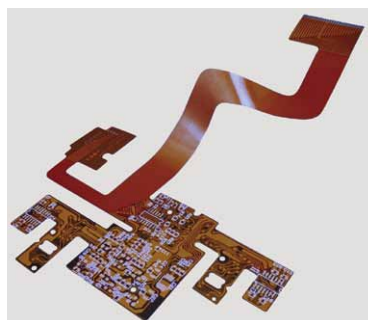


# EMI 대책기판 & Cross-Over 기판용 도전성 Cu Paste

## DD Paste **NF2000EX**



Cu Paste배선기판 (Jumper 용도)

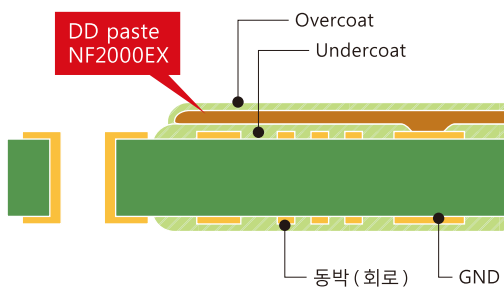


EMI 대책 Flexible 기판

### 특징

- ▶도전성 우수 ( $1.0 \times 10^{-4} \Omega\text{-cm}$ )
- ▶Ag Paste와 비교하여 내 Migration성 우수
- ▶Cost Performance 우수

### 구조



### 성질 및 물성

금속분	Cu 분	
수지	페놀수지	
용제	Butyl Carbitol	
점도 (Pa·s)	BH형	80±5
	VT04형	30±3
경화조건	160°C/30min	
체적저항률 ( $\Omega\text{-cm}$ )	$1.0 \times 10^{-4}$	
Sheet항률 ( $\text{m}\Omega\text{/sq.}$ )	25	
Tg점 ( $^{\circ}\text{C}$ )	100	
Pull강도 ( $\text{N/cm}^2$ )	600	

### 가공 프로세스



### 장기신뢰성

항목	체적저항률
초기	$1.0 \times 10^{-4} \Omega\text{-cm}$
Solder내열성 (260°C/10sec/3cycle)	$\Delta R \leq 5\%$
고온방치 (85°C/2000h)	$\Delta R \leq 30\%$
항온항습방치 (60°C/95%RH/2000h)	$\Delta R \leq 30\%$
열충격성 (-55°C/30min $\leftrightarrow$ 125°C/30min/500cycle)	$\Delta R \leq 30\%$
PCT (121°C/2atm/100%RH/8h)	$\Delta R \leq 5\%$

※참고치이며 보증치는 아닙니다.